

# 笙科電子股份有限公司

## 部門工作職掌

單位		職掌概要
稽核室		協助董事會及經理人檢查、評估內部控制制度、管理規章及作業流程管理，並提供分析及建議，以確保內部控制制度得以持續有效運作。
總經理室		1. 公司未來短、中、長程發展之營運目標及計畫之擬定及修訂。 2. 監督各部室執行營運計畫以達成公司營運目標、追求永續經營。 3. 對外公共關係之建立。
新竹設計中心	設計一處 設計三處	1. 公司短期、中、長期研發計畫之規畫及執行。 2. 新產品之研發與認證、專利技術之建立與申請。
	產品佈局一部	1. 基本電路元件(含特殊元件)、新舊產品之佈局設計作業。 2. 產品除錯/驗證工程之協尋作業。
	設計服務部	1. 積體電路代工廠提供之開發工具的管理。 2. 積體電路佈局驗證程式的問題排除。 3. 積體電路之自動佈局及其驗證。
台北設計中心	設計二處 設計四處	1. 公司短期、中、長期研發計畫之規畫及執行。 2. 新產品之研發與認證、專利技術之建立與申請。
	產品佈局二部	1. 基本電路元件(含特殊元件)、新舊產品之佈局設計作業。 2. 產品除錯/驗證工程之協尋作業。
業務中心	產品企劃部	1. 新產品行銷策略之建立及執行。 2. 新產品開發進度之追蹤與各部門工作之協調。 3. 新產品基礎客戶之開發與市場推展。 4. 提供產品線總體市場分析報告-TAM analysis。
	業務一部 業務二部 業務三部	1. 年度銷售目標及營業計畫之擬定及執行，以達成年度行銷目標。 2. 新市場、新客戶之開發，以提升市場占有率。 3. 服務客戶各項需求及客戶訴怨受理與處理。
	深圳代表處 上海代表處	1. 大陸市場及新客戶之開發，以提升市場占有率。 2. 服務客戶各項需求及客戶訴怨受理與處理。
	日本代表處	1. 新市場、新客戶之開發，以提升市場占有率。 2. 服務客戶各項需求及客戶訴怨受理與處理。
管理中心	財務部	1. 統籌公司的財務、會計、稅務及經營分析等事宜。 2. 年度預算之編製、彙總及控制。 3. 各項理財活動之調度及運用。 4. 公司股東會、董事會及股務作業相關事宜。
	人事部	1. 行政制度之擬定與實施、各項人事管理作業之規畫及執行。 2. 各項教育訓練之規畫及執行。 3. 各項薪酬與獎懲制度之規畫及執行。

生產管理中心	生產企劃部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬定年度生產計畫及物料需求計畫及管理。</li> <li>2.產能規畫及管理。</li> <li>3.各項存貨之倉儲、管理與收發。</li> <li>4.各項成品銷貨運輸作業之管理。</li> <li>5.各項採購策略、採購計畫之規畫及執行。</li> </ol>
	品質保證部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司標準化、品質系統/活動之維護及推動。</li> <li>2.文件及記錄管制作業。</li> <li>3.禁限用物質調查及管理。</li> <li>4.外包廠商之評鑑、品質督導、異常處理。</li> <li>5.半成品及成品之抽檢。</li> <li>6.實驗室儀器校正管理。</li> <li>7.協助產品開發之相關可靠度實驗、失效分析、專利申請。</li> </ol>
	產品測試部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.開發/維護產品相關之測試程式、增加程式功能，使其能提供量產/工程數據。</li> <li>2.提昇測試程式之偵錯能力，以增進出貨品質；提昇程式效率，節省測試時間。</li> <li>3.量產產品生產狀況之掌握與維護。</li> <li>4.提昇工程能力，解決產品相關之技術問題。</li> </ol>
系統應用中心	韌體設計部 韌體應用部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.協助 IC 設計及企劃部門訂定新產品數位電路規格。</li> <li>2.驗證新開發產品(FPGA/IC)能符合實際應用規格。</li> <li>3.新產品使用及開發平台發展。</li> <li>4.標準化產品軟體模組開發。</li> <li>5.配合業務部門進行新產品的推展。</li> <li>6.客戶使用產品問題處理及分析。</li> <li>7.產品量產系統開發。</li> </ol>
	硬體應用部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.協助設計 IC 應用之 PCB 佈局及基本電路元件(含特殊元件)之佈局設計作業。</li> <li>2.設計 Module 之應用及驗證，確保新開發產品能符合實際應用規格。</li> <li>3.驗證 IC 應用之溫度測試及特性分析、產品除錯/驗證工程之作業。</li> <li>4.客戶退貨及故障產品之應用分析。</li> <li>5.產品應用狀況之掌握與維護。</li> </ol>
	工程支援部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.協助工程師焊接 Module。</li> <li>2.協助工程樣品製作。</li> <li>3.提供業務需求的 Module。</li> </ol>
	晶片驗證部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.設計 IC 驗證之 PCB 佈局。</li> <li>2.設計 Module 之應用及驗證。</li> <li>3.驗證 IC 應用之溫度測試及特性分析。</li> <li>4.撰寫特定應用參考設計規格書。</li> <li>5.確保新開發產品能符合實際應用規格。</li> </ol>
	軟體應用部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.提供客戶標準化軟體程式庫。</li> <li>2.撰寫標準化軟體程式庫使用說明書。</li> <li>3.協助客戶順利整合標準化軟體程式庫，讓客戶能自行客製化應用軟體。</li> </ol>
	資訊服務部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.各項電腦化資訊系統軟體、硬體之規畫及執行。</li> <li>2.各項電信系統及委外工程之協調與管理。</li> <li>3.協助各部門之工作資訊科技化。</li> </ol>